

## LX-M1903 丙烯酸酯结构胶

### 产品描述

兰科盛™ LX-M1903 是双组分丙烯酸酯结构胶，两组份按 10:1 混合，操作时间 3~4 分钟，常温下 7~8 分钟可达到 75%的最终强度。产品无腐蚀，低卤素，设计用于电子产品的结构部件。LX-M1903 对金属、工程塑料的适应性极强，具有耐温、耐疲劳、耐冲击韧性等优异性能。

常温固化。适当加温可加速产品固化。

### 产品特征

- 适合铝合金、镁铝合金、不锈钢、普通碳钢等金属材料；
- 与非金属材料如 ABS、亚克力、PVC、DCPD、不饱和聚酯、乙烯基酯等粘接性好，强度高；
- 固化快，适合要求高效率粘接的场合。

### 主要用途

- 适合手机背板，屏幕的粘接；
- 适合笔记本/Pad 屏幕及背板粘接；
- 其他显示屏粘接应用；
- 其他高强度、耐冲击粘接应用。

### 技术参数<sup>①</sup>

项目	技术指标
外观 (A:B)	米白色/蓝色
粘度@23℃ (mPa·s)	110000:30000 (A:B)
比重 (g/ml) (A / B )	0.96 / 1.07
混合比例 (体积比)	10:1
混合比例 (重量比)	9:1
混合方式	静态混合管
操作时间@23℃ min	3~4
夹固时间@23℃ min	8~9, 适当温度加热可快速固化
闪点 (℃)	11
硬度 邵 D	65
拉伸强度 MPa ASTM D638	15~17
断裂伸长率 % ASTM D638	30~60%
拉伸剪切强度 MPa ASTM D1002	13~17 (A16061/ A16061, CF) 6 (ABS/ABS , SF)
热剪切强度@80℃	7.0 (A16061/ A16061, CF)
T 剥离强度 (KN/M)	7.5
工作温度/℃	-40~121

①在 23±2℃、50±5%RH 下的检测数据。

**安全注意事项:**

本品属于易燃品, 请将本品远离火焰、高热及火花保存或使用。本品含丙烯酸酯成分, 应放置在儿童拿不到的地方。使用完请盖好放置。尽量避免皮肤、眼睛接触, 如不慎接触皮肤可用肥皂尽快洗涤, 接触眼睛后可用大量清水冲洗15分钟并尽快就医。本品不可吞食。详情请见物质安全资料表。另外: 因本品固化很快, 大量混合时产生很多热量, 可能会伴有气体、蒸汽等挥发物的释放。为此, 每次在混合时应以操作时间内能用完的数量为限, 并将粘结厚度控制在适当范围。操作应用问题可直接与兰科盛™公司取得联系。

**混合&及施胶:**

LX-M1903结构胶是双组份产品。主剂和固化剂通过卡筒定比例挤出后由静态混合管充分混合。建议使用气动胶枪, 它能提供比手动胶枪更稳定的压力和混合效果。对大型工件, 建议使用施胶设备混合/涂胶(设备选用请咨询兰科盛™公司技术人员)。所有混合设备应选不锈钢、铝、特富龙或PE材质过流部件, 过流部件不得采用铜或铜合金。密封圈要使用特富龙、特富龙包覆的PVC、PE/PP, 不得采用丁腈橡胶、氯丁橡胶或其他弹性体, 有关混合注意事项请直接致电兰科盛™公司。

**操作&清理:**

为达到最佳粘结强度, 粘结操作必须在操作时间内完成。粘接时, 须有足够量的胶水保证粘接面满涂。操作时间结束前, 涂胶和工件定位务必准确完成, 然后保持工件固定状态直到夹固时间结束方可移走。胶水固化前很容易清理, 可用含柠檬酸萜烯树脂的清洗剂或去脂剂擦洗以达到最佳效果; 如胶层已经固化, 需用机械方法将胶层铲/刮掉, 并用清洗剂擦洗干净。

**温度的影响:**

本品在 18°C-27°C 下施工能达到最理想的固化效果, 低于18°C固化减慢, 超过27°C固化加快。主剂和固化剂的粘度也受温度的影响, 为确保在计量/混合设备中混合效果的一致性, 两个组分在储存时的温度要保持恒定。

**运输贮存**

- 密封并贮放在低温、干燥处, 在规定保存温度 12°C-24°C 下保存期为 9 个月, 以产品出厂的日期为准。
- 长期超过 24°C 存放会缩短产品的保存期, 避免将固化剂或装有固化剂的卡筒胶置于 37°C 以上环境中长期存放, 这将大大降低组分的反应活性。7°C-12°C 存放能延长保存期。
- 运输: 防潮, 防雨淋, 防晒, 防高温, 远离热源, 小心轻放, 禁止挤压碰撞。
- 本品不能冷冻保存。

**包装规格**

容量	包装	代码
50ml/支	卡筒包装	M190350

**特别声明:** 所有测试数据是基于实验室受控条件下所得, 不作为客户设计的依据。产品在正常的使用条件下储存、处理、施工建议都是基于本公司目前的知识和经验所提供, 而实际应用中, 由于环境、所用材料和实际现场条件的不同, 对任何从本表中的数据参数推断产品特殊用途的适用性, 本公司不作任何担保和承担任何法律责任。为保证粘接效果及产品与材料的相容性, 建议事先在应用环境下对实际的基材做相容性试验或咨询本公司技术人员。